

セミアディティブ法対応 LCPフィルムへの無電解銅めっきプロセス

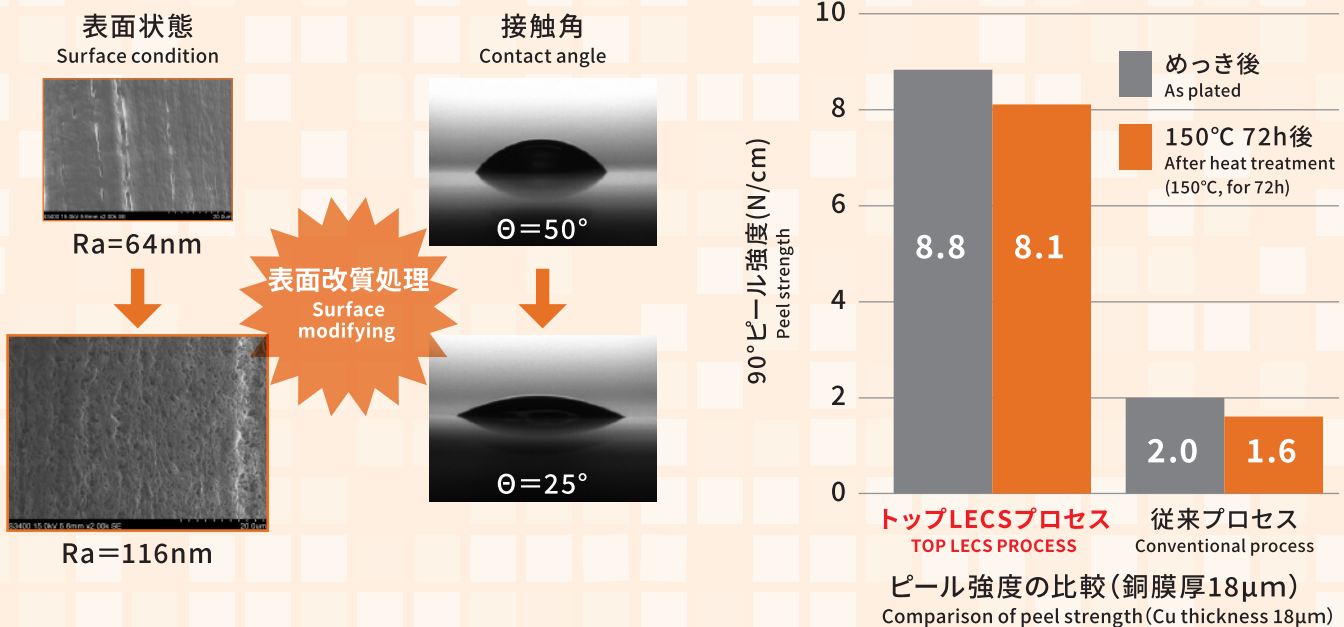
Applicable for SAP
Electroless Copper Plating Process to LCP Films

トップLECSプロセス

TOP LECS PROCESS

- 高周波高速伝送に適したLCPフィルムへのめっきプロセス
Realize plating to LCP films suitable for high-frequency, high-speed transmission
- 全湿式プロセスであり、無電解銅めっきが直接可能
All steps : Wet process/Realize direct electroless copper plating on LCP films
- 密着性に優れる
Excellent in adhesion
- セミアディティブプロセスに対応し、ファインパターン性に優れる
Applicable for SAP and excellent in fine pattern ability

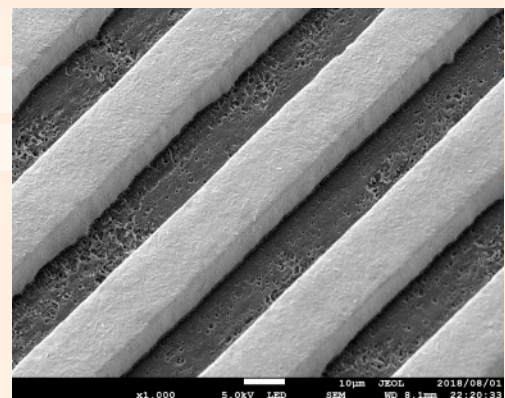
低粗度でも高いピール強度が得られ、高速伝送に適する
High peel strength to low Ra material, suitable for high-speed transmission



全工程湿式プロセスによる無電解銅めっき
Electroless copper plating by all wet process

表面改質 Surface modifying	トップLECSプリコンディショニング TOP LECS PRECONDITION
コンディショニング Conditioning	トップLECSコンディショナー TOP LECS CONDITIONER
プリディップ Pre-dipping	トップLECSプリディップ TOP LECS PREDIP
触媒付与 Catalyzing	トップLECSカタリスト TOP LECS CATALYST
活性化 Accelerating	トップLECSアクセレーター TOP LECS ACCELERATOR
無電解銅めっき Electroless copper plating	トップLECS銅 TOP LECS COPPER

ファインパターン性に優れる
Excellent in fine pattern ability



パラジウム吸着量が少なく、パターンニング性に優れる
Reduce Pd adsorption amount,
excellent in pattern forming performance